

FORMAPad®

Fluidos termo-condutores



Descrição

A linha FORMAPad® é composta por fluidos termo-condutores, formulados com o objetivo de oferecer um equilíbrio entre os benefícios proporcionados por materiais do tipo 'gel', como a baixa resistência térmica. Essa linha está disponível em modelos mono ou bi-componente, para curas a temperatura ambiente ou em estufas. Os fluidos termo-condutores FORMAPad® podem ser aplicados manualmente em espessuras muito baixas e causam reduzido nível de stress mecânico a componentes eletrônicos.



Características

- Baixíssima resistência térmica
- Alta conformabilidade
- Eletricamente isolante
- Compatíveis com RoHS, Reach e UL 94-V0



Aplicações

- Centrais de Comando Automativas (ECUs)
- Semicondutores e Fontes Elétricas
- Equipamentos para Fibras Ópticas™



Formatos

- Seringas de 30ml
- Bisnagas com 300ml



Propriedades Típicas

Propriedade	Norma	Unidade	FP 2004	FP 2301
Tipo	-	-	2 partes Silicone	1 parte Silicone
Cor	-	-	Rosa	Branco
Viscosidade	Brookfield	Pa.s	150	-
Proporção de Mistura	-	-	1:1	-
Densidade	ASTM D792	g/cm ³	2,80	1,29
Condutividade Térmica	2,0	W/m.k	1,00	0,20
Resistividade Volumétrica	ASTM D257	Ohm.m	10 ¹²	10 ¹²
Dureza	ASTM D2240	Shore 00	70,00	35,00
Tempo de Cura a 25°C	-	-	24-48h	24 h
Tempo de Cura a 100°C	-	-	20 min	-
Resistência a Temperatura	ASTM D5470	°C	-55 a 200	-55 a 260
Resistência Elétrica	ASTM D149	kV/mm	12,0	12,0
Validade em Estoque	-	-	12 meses	12 meses
Flamabilidade	UL 94	-	V0	V0